

맞춤형 Ptfе 웨이퍼 캐리어 플라워 바스켓 내화학성 반도체 세척 핸들 디자인

품목 번호: PL-CP166



소개

맞춤형 PTFE 웨이퍼 캐리어와 플라워 바스켓으로 반도체 수율을 극대화하세요. 불산 및 강한 시약에 대한 우수한 내성을 갖도록 설계된 이 고순도 핸들링 시스템은 인체공학적 핸들과 정밀 CNC 가공 슬롯을 적용하여 안전하고 오염 없는 습식 공정 세척을 구현합니다.

자세히 알아보기

적용 분야	설명	주요 이점
RCA 세척 공정	SC-1 및 SC-2 용액을 사용한 순차 세척으로 유기 잔류물과 금속 오염물을 제거합니다.	욕조에 불순물을 용출하지 않으면서 높은 pH와 산화 스트레스에 견딩니다.
불산 에칭	농축 HF를 사용하여 실리콘 웨이퍼에서 자연 산화막 또는 희생 유리층을 제거합니다.	유리를 용해시키거나 표준 플라스틱을 열화시키는 HF에 완전한 내성을 보딩니다.
피라냐 에칭 / 스트립	황산과 과산화수소 혼합물을 사용하여 심한 유기 오염 또는 포토레지스트를 제거합니다.	피라냐 용액으로 발생하는 높은 발열 온도에서도 구조적 무결성을 유지합니다.
포토리소그래피 현상	UV 노출 후 회로 패턴을 정의하기 위해 웨이퍼를 현상액에 침지합니다.	정밀 슬롯 가공으로 웨이퍼 표면이 현상액에 균일하게 노출되도록 합니다.
CMP 후 린싱	화학 기계적 연마 후 슬러리 입자를 제거하기 위한 고순도 린싱을 진행합니다.	논스틱 표면으로 슬러리 축적을 방지하고 빠르고 안전한 오염 제거를 돕습니다.
화합물 반도체 제조	고주파 전자제품 및 LED 제조를 위한 GaAs, InP 또는 SiC 웨이퍼 공정을 진행합니다.	부드러운 핸들링 특성으로 더 취약한 화합물 소재의 파손을 방지합니다.
초음파 / 메가소닉 세척	서브마이크로 입자를 탈착하기 위해 고주파 음향 세척 중에 웨이퍼를 지지합니다.	음향 캐비테이션 힘 하에서도 우수한 진동 감쇠와 화학적 안정성을 제공합니다.
사양 카테고리	PL-CP166 파라미터 세부정보	맞춤화 옵션
주요 소재	고순도 버진 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)	향상된 투명성/순도를 위해 PFA 옵션 선택 가능
웨이퍼 사이즈 호환성	4인치(100mm), 6인치(150mm), 8인치(200mm)	사용자 정의 직경 및 비표준 형태 제공 가능
슬롯 구성	정밀 컷 V-그루브 또는 U-그루브 프로파일	사용자 정의 슬롯 피치, 깊이 및 각도 간격
용량	표준 25웨이퍼 또는 50웨이퍼 구성	단일 웨이퍼부터 대용량까지 맞춤형 배치 사이즈
핸들 디자인	일체형 탑마운트 또는 사이드마운트 핸들	탈착식, 연장형 또는 자동화 호환 핸들
내화학성	전 범위 (산, 염기, 용매, 산화제)	HF, H2SO4, HNO3, HCl, NH4OH 등에 대해 검증 완료
작동 온도	-200°C ~ +260°C	특정 열 사이클링 프로파일에 맞춤 제작 가능
제조 방식	엔드투엔드 맞춤형 CNC 가공	자동화 인터페이스를 위한 정밀 공차 제어
세척 프로토콜	클린룸 세척 후 진공 밀봉	미량 분석을 위한 특수 전처리 세척